

2024-2학기

첨단반도체 분야 융합전공 학생모집

미래 인재가 온다! 2024년 첨단반도체 분야 융합전공 신설!

+ 모집 안내

- 신청 기간 2024. 07. 01.(월) 10:00 - 07. 12.(금) 17:00까지 (학적변동기간 내 신청)
- 신청 대상 2학년 이상(2학년 1학기 개시 전 ~ 4학년 2학기 개시 전까지)
- 신청 방법 [본 대학 홈페이지] ▶ [학생 종합정보시스템] ▶ [학적관련정보] ▶ [융합전공신청]
- 신청 구분

융합전공	편성교과목 중 36학점 이상 이수 시 학위 부여
융합부전공	편성교과목 중 21학점 이상 이수 시 학위 부여

※융합전공자는 주전공 졸업이수학점이 감소되며, 부융합전공자는 감소되지 않음
- 참여 혜택 2024-2학기 내 편성교과목 6학점 이상 이수시, 장학금 40만원 및 해외탐방 기회 제공

+ 융합전공 교육과정

반도체소재·소자 융합전공			
편성학기	과목번호	과목명	학점-이론-실기
2-1	40960	전기전자회로실험	3-0-3
2-1	22677	재료과학1	3-3-0
2-1	37708	전자회로	3-3-0
2-2	41375	광반도체개론	3-3-0
2-2	38833	디지털회로실험	3-3-0
2-2	44110	재료열역학	3-3-0
3-1	40421	광전자공학실험1	3-0-3
3-1	43797	마이크로전자및패키징기술	3-3-0
3-1	39569	반도체소자	3-3-0
3-1	46698	반도체소자실습	3-0-3
3-2	23523	반도체공정	3-3-0
3-2	23964	반도체공학	3-3-0
3-2	46699	반도체구조이해및설계	3-0-3
3-2	37473	센서공학	3-0-3
4-1	40968	반도체공정실습	3-0-3
4-2	41264	캡스톤디자인	3-0-3
		현장실습(단기)	3-0-3
		반도체공정실무	3-0-3

첨단반도체패키징 융합전공			
편성학기	과목번호	과목명	학점-이론-실기
2-1	22677	재료과학1	3-3-0
2-1	37708	전자회로	3-3-0
2-1	43788	전기전자	3-3-0
2-2	44110	재료열역학	3-3-0
2-2	37197	철강재료	3-3-0
2-2	41375	광반도체개론	3-3-0
3-1	43797	마이크로전자및패키징기술	3-3-0
3-1	39569	반도체소자	3-3-0
3-1	41722	나노재료공학	3-3-0
3-2	23523	반도체공정	3-3-0
3-2	43804	패키징실습	3-0-3
3-2	43792	마이크로솔더링및접합	3-3-0
3-2	43731	패키징신뢰성평가	3-3-0
4-1	46732	첨단패키징장비개론	3-3-0
4-1	40968	복합솔더설계및물성분석	3-0-3
4-2	41264	캡스톤디자인	3-0-3
		현장실습(단기)	3-0-3
		반도체공정실무	3-0-3

- ※ 특성화 융합전공에서 개설된 캡스톤디자인, 현장실습(단기) 교과목 필수이수
- ※ 첨단반도체 관련 자격증 취득 시 반도체공정실무 교과목 특별학점 3학점 이내 학점인정
- ※ 기타 문의사항은 담당자에게 문의 바랍니다. (첨단반도체연구센터 062-230-7649)